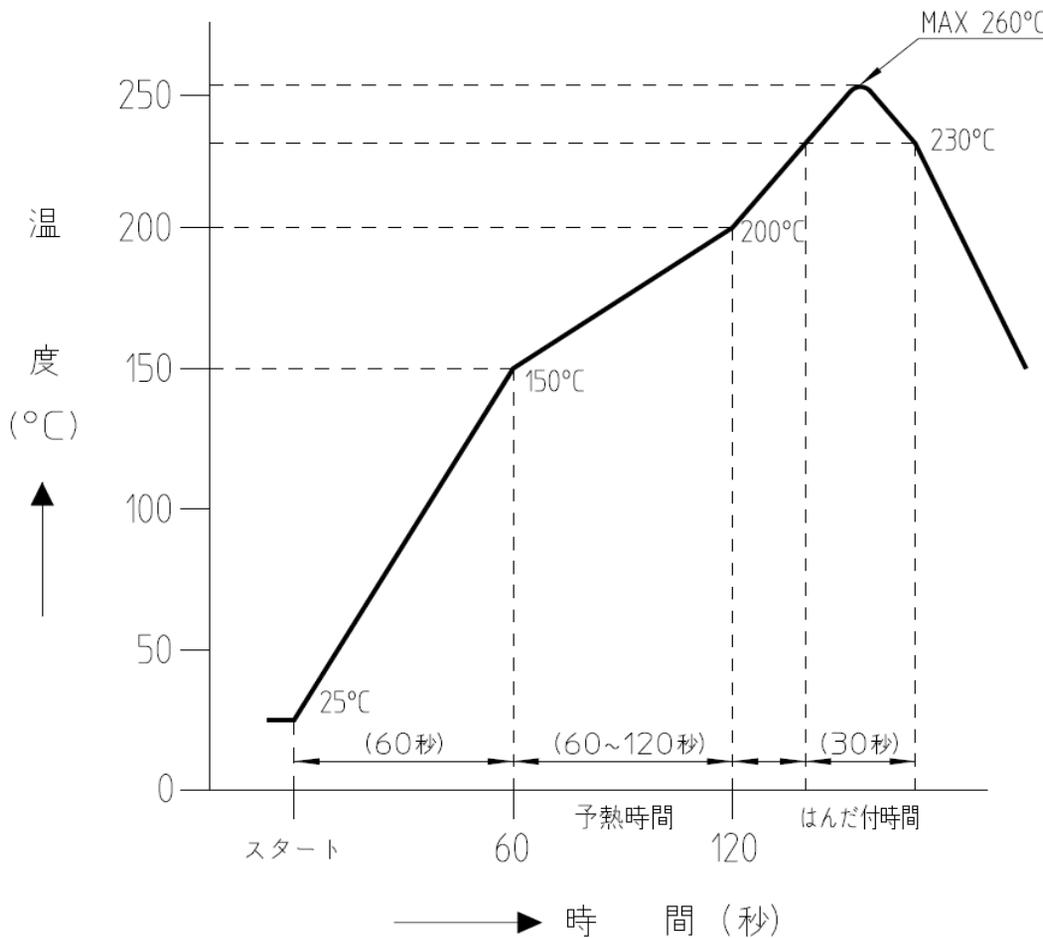


	△の数	訂正記事	担当	検討	年月日		△の数	訂正記事	担当	検討	年月日
△1	10	RE-5-1840	Y. K. G	A. B. H	17. 12. 05	△4	1	RE-5-2840	P. S. H	A. B. H	22. 07. 18
△2	1	RE-5-2031	K. C. J	A. B. H	18. 09. 07	△5	2	RE-5-2935	K. C. J	A. B. H	23. 01. 11
△3	3	RE-5-2373	P. J. H	A. B. H	20. 04. 24	△					
適用規格											
定格	使用温度範囲	-40℃ ~ 85℃ (注1)			保存温度範囲			-10℃~60℃(梱包状態)			
	電圧	AC 10V			使用・保存湿度範囲			相対湿度95%以下 (ただし、結露しないこと。)			
	電流	0.5A									
性能											
項目		試験方法				規格				QT	AT
構造											
外観・構造・仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				X	X
表示										X	X
電気的 特性											
低電圧、低電流下の接触抵抗 IEC60512-2-1		開放電圧20 mV、試験電流1 mA で測定する。				60mΩ以下(信号)(初期値)。(注2) 200mΩ以下(SW)				X	-
絶縁抵抗 IEC60512-3-1		DC 500Vの電圧を印加し1分以内に測定する。				1000MΩ 以上 (初期値)。				X	-
耐電圧 IEC60512-4-1		信号 : 500Vrmsを1分間印加する。 その他 : 375Vrmsを1分間印加する。				① せん絡・絶縁破壊がないこと。 ② 漏洩電流1mA以下。				X	X
機械的 性能											
挿抜寿命 [オフィス環境] EIA364B class 1.1		1分間に10サイクル以下の速度で、10,000サイクルの挿抜を行う。 ※10サイクルごとに5~10分間は繰り返し動作を休止させる。 また、 初期~1,000サイクル : 100回毎、計10回 1,001~10,000サイクル : 1,000回毎、計9回の各休止時に、エアブローにより、カード表面への付着物を除去させる。				① 接触抵抗 : 初期からの変化量 100mΩ以下(信号) 300mΩ以下(SW) ② 極度の摩耗や破損等の異常がないこと。				X	-
カード挿入力		スピード25±3mm/minにて適合カードで測定する。				3N ~ 7N (注3)				X	-
カード排出力											
振動・高周波 IEC60512-6-4		片振幅 0.75mm、周波数10~55~10Hzの振動をX、Y、Z軸3方向各4時間、計12時間加える。				① 1μsの電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				X	-
衝撃 IEC60512-6-3		加速度490m/s ² 、待続時間11msの正弦半波で3軸方向各3回、計18回の衝撃を加える。				③ 接触抵抗: 初期からの変化量 100mΩ以下(信号) 300mΩ以下(SW)				X	-
参照図											
備考			製 図	担 当	検 討	承 認	出 図				
(注1): 通電による温度上昇を含む。 (注2): 接触抵抗は導体抵抗を含む。規定無き場合は温度15~35℃、気圧86~106kPa、湿度25~85%の試験環境下にて実施のこと。 (注3): トレイ/カードの材質や寸法によって変更される場合があります。			J. H. CHOI 15. 02. 23	J. H. CHOI 15. 02. 23	J. H. CHOI 15. 02. 23	H. C. SONG 15. 02. 23					
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 X: 適用項目											
HIROSE KOREA CO., LTD.				製品規格表				製品名. DM3NW-SF-PEJ(800)			
製品コード.(前) CL			図番. JLC4-631423			製品コード. CL 6533-0019-0-800			1 2		

性能		規格	QT	AT
項目	試験方法			
環境的性能				
耐湿性温度サイクル IEC60512-11-12	1サイクル24時間で10サイクルの嵌合放置をする。 		X	-
熱衝撃 IEC60512-11-4	温度 -55℃~ 85℃、変化時間 5分以内で 5サイクル (1サイクル=1h) の嵌合放置をする。	① 接触抵抗 : 初期からの変化量 100mΩ以下(信号) 300mΩ以下(SW)。	X	-
耐熱性 IEC60512-11-9	温度 85℃に 96hの嵌合放置をする。	② 絶縁抵抗 : 100MΩ 以上。	X	-
耐寒性 IEC60512-11-10	温度 -40℃に 96hの嵌合放置をする。	③ 機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	X	-
耐 湿 (定常状態) IEC60512-11-3	温度 40℃、湿度90~95RH中に96hの嵌合放置をする。		X	-
硫化水素 JEIDA 38	3ppmの硫化水素で暴露, 温度 40℃、湿度80RH中に 96hの嵌合放置をする。			
塩水噴霧 IEC60068-2-11	温度 35±2℃、5%塩水スプレー、48hの嵌合放置をする。		X	-
推奨温度プロファイル	以下の条件で1サイクルを行う。(注4)	機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	X	-

(注4)



参照図

注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 X: 適用項目

HIROSE KOREA CO., LTD.	製品規格表	製品名. DM3NW-SF-PEJ(800)
製品コード.(前) CL	図番. JLC4-631423	製品コード. CL 6533-0019-0-800